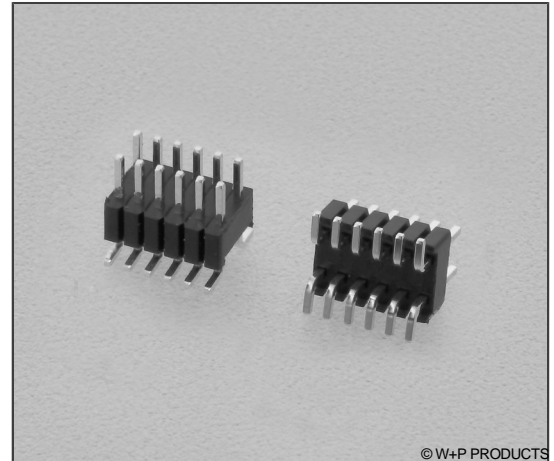


46-7070 Economy Version

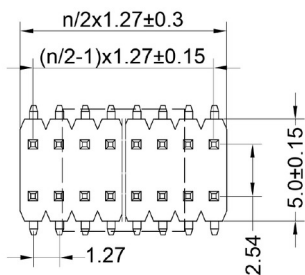
SMT-Stiftleisten RM 1,27x2,54mm, stehend, 2-reihig - 0,46mm Vierkantstift
SMT Pin Headers, 1.27x2.54mm Pitch, Vertical, Double Row - 0.46mm Square Pin

Technische Daten / Technical Data

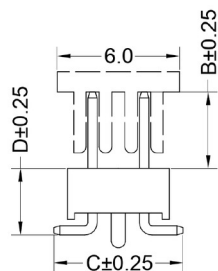
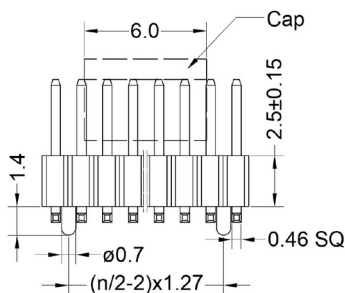
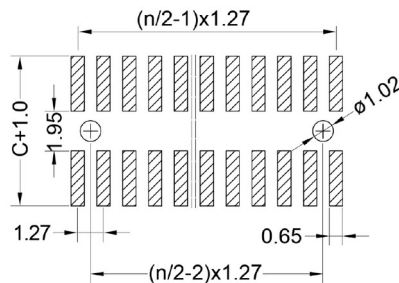
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Au über Ni
Contact Surface	Au over Ni
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC/DC
Test Voltage	500 V AC/DC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-40 °C ~ +105 °C
Temperature Range	-40 °C ~ +105 °C
Verarbeitung	260 °C für 10 sec. / 230 °C für 30-60 sec.
Processing	260 °C for 10 sec. / 230 °C for 30-60 sec.



© W+P PRODUCTS



Recommended P.C.B Layout (Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE ± 0.05)



Series	Contacts*	Dimensions*	Plating	Locating Pegs*	Packaging*
46-7070	016 004-060 Zweireihig Double row	10 Ohne Positionierhilfen W/o locating pegs 10 B=2.80 C=6.50 D=3.81mm 20 B=6.00 C=6.50 D=3.81mm 99 Kundenspezifisch Customer-specific Mit Positionierhilfen With locating pegs 30 B=2.80 C=6.50 D=3.00mm 40 B=6.00 C=6.50 D=3.00mm 99 Kundenspezifisch (D=3.0mm) Customer-specific (D=3.0mm)	00 00 Vergoldet Gold plated	00 00 Ohne Pos. hilfen W/o loc. pegs 10 Mit Pos. hilfen With loc. pegs	ST ST PPST PPTR (Option)

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads
PPST In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads
PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb T_L	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	Lower Temperature [°C]
Duration above T_L	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

